

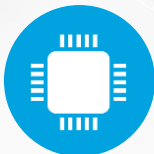
FRANCE  
**Seica**

**CATALOGUE**  
PRODUITS ET SERVICES



[www.seica.fr](http://www.seica.fr)

# SOMMAIRE



P. 03 ..... Test à sondes mobiles  
P. 07 ..... Test à lit de clous  
P. 13 ..... Inspection THT/CC  
P. 14 ..... Inspection AOI  
P. 16 ..... Inspection AXI

P. 18 ..... Contrôle et stockage de composants  
P. 19 ..... Comptage de composants  
P. 20 ..... Marquage PCB  
P. 21 ..... Sérigraphie  
P. 21 ..... Four de refusion  
P. 23 ..... Brasage laser  
P. 24 ..... Transitique CMS et vague

P. 28 ..... Monitoring de ligne

P. 29 ..... Impression 3D  
P. 34 ..... Scannérisation 3D



## Seica

### PILOT H4 NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST DES PCBA

Grâce à son convoyeur SMEMA intégré en option, le Pilot H4 Next>Series est un testeur à sondes mobiles traditionnel éliminant le besoin de la présence d'un opérateur devant le système de test. C'est la solution idéale pour les moyens et gros volumes de production de tests en horizontal.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Système équipé avec 4 sondes mobiles électriques
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, FEASA, et optique
- Architecture horizontale compatible SMEMA facilement intégrable dans une ligne de production (option)
- Programmation automatique avec l'importation de données par Valor Process Preparation de Valor MSS
- Gestion des canaux fixes et alimentations additionnelles en plus des sondes mobiles
- Stations de programmation et de réparation hors ligne



EN SAVOIR +

## Seica

### PILOT V8 NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST DES PCBA

Le Pilot V8 Next>Series est la solution la plus complète avec un maximum de performances : grande vitesse de test, adaptée pour les faibles à moyens volumes de production, fabrication ou la réparation. Son architecture permet de tester les deux côtés de la carte simultanément.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Système équipé avec 8 sondes mobiles électriques (4 de chaque côté)
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, FEASA, et optique
- Architecture verticale pour réduire les vibrations de la carte
- Programmation automatique avec l'importation de données par Valor Process Preparation de Valor MSS
- Chargement de la carte manuel ou automatique (empileur/dépilleur optionnel)
- Capacité de lecture sur les deux faces de codes à barres et de codes en 2D



EN SAVOIR +

## Seica

### PILOT VX NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST DES PCBA

Le Pilot VX Next>Series est la solution la plus rapide avec un maximum de performances : très grande vitesse de test, adaptée pour les faibles à moyens volumes de production, fabrication ou la réparation. Son architecture permet de tester les deux côtés de la carte simultanément.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Système équipé avec 8 têtes mobiles (4 de chaque côté)
- Possibilité de contacter jusqu'à 60 points en simultané
- Déplacements des axes X et Y à très grande vitesse (50% plus rapide qu'un Pilot V8).
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, FEASA, et optique
- Capacité de lecture sur les deux faces de codes à barres et de codes en 2D
- Large choix de transtique associée pour fonctionnement en full-automatic

NEW



EN SAVOIR +

## Seica

### PILOT BT NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST DES BATTERIES EV

Pour répondre aux besoins techniques du test des batteries lithium-ion des véhicules électriques, Seica a développé le Pilot BT Next>Series. Il permet tous les types de batteries grâce à un système de convoyage Seica ou d'un système personnalisé conçu ou choisi par le client.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 4 têtes de test indépendantes entraînées par des moteurs synchrones sans balais (XYZ),
- Chacune des quatre têtes est dotée d'un mini dispositif permettant de tester jusqu'à quatre cellules individuelles en un seul mouvement dans une orientation sur l'axe X ou Y
- Quatre outils de mesure de résistance stabilisés et isolés thermiquement, qui permettent de mesurer la résistance d'adhésion d'une seule cellule de batterie à la plaque commune
- Capable d'effectuer des tests Kelvin parallèles très précis de 16 cellules à la fois, atteignant des cadences de production de près de 2400 cellules de batterie par minute



EN SAVOIR +

## Seica

### RAPID H4 NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST CÉRAMIQUES ET FLEX

Pour répondre aux exigences spécifiques d'un marché où la plupart des céramiques ont des points de test sur une face, Seica a introduit les testeurs Rapid H4 Next>Series, équipés de 4 sondes sur la face supérieure en chargement manuel ou automatique.

##### CARACTÉRISTIQUES

- 4 sondes mobiles indépendantes
- Grâce à la troisième génération de technologie de guidage linéaire, le Rapid H4 Next>Series est capable d'atteindre une vitesse très élevée avec une précision et une répétabilité de mesure maximales
- 1 caméra CCD HD au niveau de la sonde pour les tests d'alignement optique et de vision (Top)
- Zone de test jusqu'à 540 mm x 610 mm (21" x 24")
- Version manuelle et automatique compatible SMEMA passage du convoyeur de gauche à droite
- Possibilité de tester des flex en reel-to-reel (version spécifique)



EN SAVOIR +

## Seica

### RAPID V8 NEXT>

#### TESTEUR À SONDES MOBILES POUR TEST DES PCB

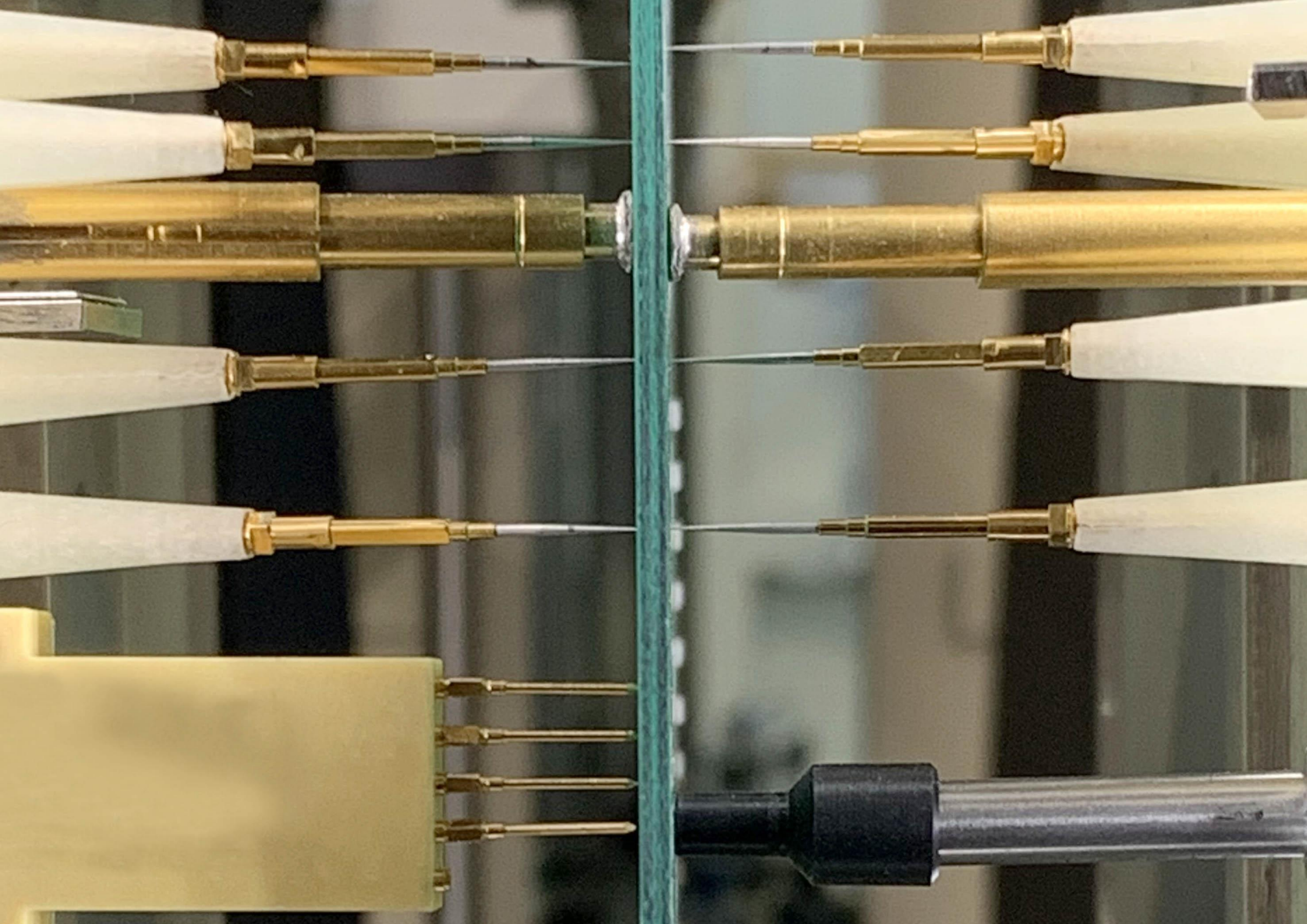
Le Rapid V8 Next>Series combine la polyvalence et l'encombrement réduit d'un système vertical avec l'automatisation des testeurs à architecture horizontale. Il répond aux exigences les plus pointues en termes de polyvalence associées à des normes de haute performance.

##### CARACTÉRISTIQUES

- Tests des couches internes, substrats céramiques, circuits imprimés flexibles et circuits imprimés
- 8 sondes mobiles indépendantes
- 2 caméras CCD (1 de chaque côté)
- Zone de test de 540 mm x 610 mm (21" x 24")
- Tests d'isolement en haute impédance, tests haute tension
- Table à vide en option
- Capacités Soft touch
- Test in-situ des composants enfouis en option



EN SAVOIR +



# Seica

## MINI 80 NEXT>

### INSTRUMENT ALL-IN-ONE POUR TESTS PARAMÉTRIQUES

Le Mini 80 Next>Series représente la miniaturisation maximale disponible à ce jour avec un testeur ATE. Toutes les capacités d'un équipement de test automatique sont disponibles dans le rack 19"/2U pour ceux qui cherchent des tests paramétriques avec peu de points de test.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Intégrable dans une baie 19 pouces (livré sans PC)
- Adaptateur de test manuel ou personnalisé
- 3 slots disponibles : jusqu'à 192 canaux analogiques ou 32 canaux numériques
- 1 Alimentation électrique de l'utilisateur (0-30V@1A)
- Programmeur embarqué universel (jusqu'à 4 disponibles en parallèle)
- Gestion des tests de boundary scan
- Lecture de codes à barres et codes 2D et collecte automatique de données statistiques
- Programmation automatique avec importation de données CAO



EN SAVOIR 

# Seica

## MINI 200 NEXT>

### INSTRUMENT ALL-IN-ONE POUR TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Dans le monde de l'ATE, Mini 200 Next>Series représente un excellent compromis en termes d'intégration et d'évolutivité. Toutes les ressources essentielles pour créer un test ICT sont disponibles dans une architecture en rack 19"/6U, y compris le PC.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Intégrable dans une baie 19 pouces (livré avec PC intégré)
- Adaptateur de test manuel ou personnalisé
- 10 slots disponibles : jusqu'à 640 canaux analogiques ou 92 canaux numériques
- 3 Alimentations électriques de l'utilisateur (0-30V@1A)
- Programmeur embarqué universel (jusqu'à 4 disponibles en parallèle)
- Gestion des tests de boundary scan
- Gestion des séquences de test fonctionnel via NI (Labview/Teststand) ou avec le système d'exploitation VIVA par SEICA
- Programmation automatique avec importation de données CAO



EN SAVOIR 

## Seica

### COMPACT CUBE NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Le besoin de petite taille, de flexibilité et d'intégration dans la plupart des environnements de fabrication a justifié le développement du testeur Compact Cube Next>Series, plus petit de la famille Compact, mais avec un grand potentiel dans les différents environnements opérationnels.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Meuble de moins de 68 cm de hauteur facilement déplaçable grâce aux quatre roues pivotantes
- Système totalement intégré avec PC intégré
- Adaptateur de test manuel ou personnalisé
- 3 slots disponibles : jusqu'à 192 canaux analogiques ou 32 canaux numériques
- Gestion des séquences de test fonctionnel via NI (Labview/Teststand) ou avec le système d'exploitation VIVA par SEICA
- Interface utilisateur totalement personnalisable (MyView) même avec l'utilisation de Teststand
- Environnement fonctionnel simplifié grâce à l'utilisation de QuickTest



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT RT NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Seica répond aux besoins de la tendance continue du marché de la miniaturisation des PCB électroniques en lançant la nouvelle Compact RT Next>Series, qui est un système entièrement automatique basé sur une table rotative, idéal pour la production à volume moyen / élevé.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Receveur et table rotative inclus
- Peut fonctionner en mode automatique (par robot / cobot) ou en mode manuel (par opérateur)
- Chargement des cartes en temps masqué
- Développé pour des concepts de lignes de manutention automatisées : Compact RT Next>Series alignés ou placés en cercle
- Identification des interfaces en RFID
- 10 slots disponibles : jusqu'à 640 canaux analogiques ou 92 canaux numériques
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Programmation automatique avec importation de données CAO



EN SAVOIR +



## Seica

### COMPACT TK NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Le Compact TK Next>Series est caractérisé par son haut niveau d'ergonomie (standard WCM), faible encombrement, facile d'entretien, faible consommation d'énergie et sécurité accrue de l'opérateur. Il peut être intégré facilement et avec succès dans un environnement de production.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Encombrement réduit et ergonomie WCM
- Existe en version 1 JOB ou 2 JOB (baie d'extension)
- Récepteur pneumatique avec doigts d'appui et sondes capacitives (option) sur le dessus
- 24 slots disponibles : jusqu'à 1536 canaux analogiques ou 736 canaux numériques
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Processeur de signal numérique (DSP) de 200 MHz pour traiter les mesures analogiques afin d'assurer un traitement rapide et efficace
- Interface utilisateur totalement personnalisable (MyView) même avec l'utilisation de Teststand



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT DIGITAL/XL/LR NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Le Compact Digital Next>Series, système plus sophistiqué avec des capacités qui vont au-delà de l'analyseur logique simple, est la réponse de Seica à la demande constante de tests de composants intégrés via des techniques vectorielles et des protocoles dédiés tels que Boundary Scan.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Récepteur à vide compatible avec les interfaces IFR/Aeroflex/Teradyne (Compact LR)
- Peut fonctionner en mode automatique (par robot / cobot) ou en mode manuel (par opérateur)
- 54 slots disponibles (XL) : jusqu'à 2048 canaux analogiques ou 2048 canaux hybrides multiplexés 1:8
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Processeur de signal numérique (DSP) de 200 MHz pour traiter les mesures analogiques afin d'assurer un traitement rapide et efficace
- Interface utilisateur totalement personnalisable (MyView) même avec l'utilisation de Teststand



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT MULTI NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

La polyvalence et l'évolutivité du système de test Compact Multi Next>Series sont parfaitement adaptées pour l'intégration d'instruments extérieurs, de capacités et de techniques en un unique banc de test à vocation fonctionnelle pour des besoins industriels et automobile.

##### CARACTÉRISTIQUES

- Existe en version 1 JOB à 4 JOB (baie d'extension)
- Récepteur dédié fonctionnel avec connectique ODU pour une meilleure intégration dans l'interface d'électronique connexe
- Espace libre pour intégrer des instruments extérieurs
- 24 slots disponibles : jusqu'à 1536 canaux analogiques ou 736 canaux numériques
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Bus et matrice d'alimentation (module HRELE)
- Gestion des protocoles de communication (série, USB, CAN, LIN, K-line, GPIB,...)
- Interface utilisateur totalement personnalisable (MyView) même avec l'utilisation de Teststand



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT SL NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Le Compact SL Next>Series offre une solution entièrement automatisée à faible emprise au sol (standard WCM), via un système de convoyeur intégré SMEMA, permettant une manipulation automatique des cartes et une intégration facile dans les lignes de production à haut volume.

##### CARACTÉRISTIQUES

- Existe en version 1 JOB à 4 JOB (baie d'extension)
- Encombrement réduit et ergonomie WCM
- Utilisation en îlot automatisé ou directement sur une ligne de production
- 24 slots disponibles : jusqu'à 1536 canaux analogiques ou 736 canaux numériques
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Gestion des séquences de test fonctionnel via NI (Labview/Teststand) ou avec le système d'exploitation VIVA par SEICA
- Gestion des protocoles de communication (série, USB, CAN, LIN, K-line, GPIB,...)
- Compatible Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT DIGITAL TOWER NEXT>

#### TESTEUR À LIT DE CLOUS TESTS IN-SITU/FONCTIONNELS

Le Compact Digital Tower Next>Series est la réponse de Seica à la demande constante d'intégrer dans une ligne complète une solution de test polyvalente. Son ergonomie spécialement étudiée pour se connecter aisément à des handlers externes existe en 3 configurations différentes.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomie étudiée pour l'intégration à des handlers externes
- Configuration 1 job, 2 jobs ou 4 jobs (4 systèmes indépendants sont combinés en 1)
- Test in-situ et fonctionnel, programmation sur carte, boundary scan, et FEASA
- Jusqu'à 2048 canaux hybrides (1:8)
- Intègre 2 racks standards situés dans la partie inférieure pour réduire la longueur des câbles
- Évolutivité pour le test fonctionnel
- Interface utilisateur totalement personnalisable (MyView)
- Programmation embarquée



EN SAVOIR +

## Seica

### COMPACT BMS NEXT>

#### TESTEUR BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)

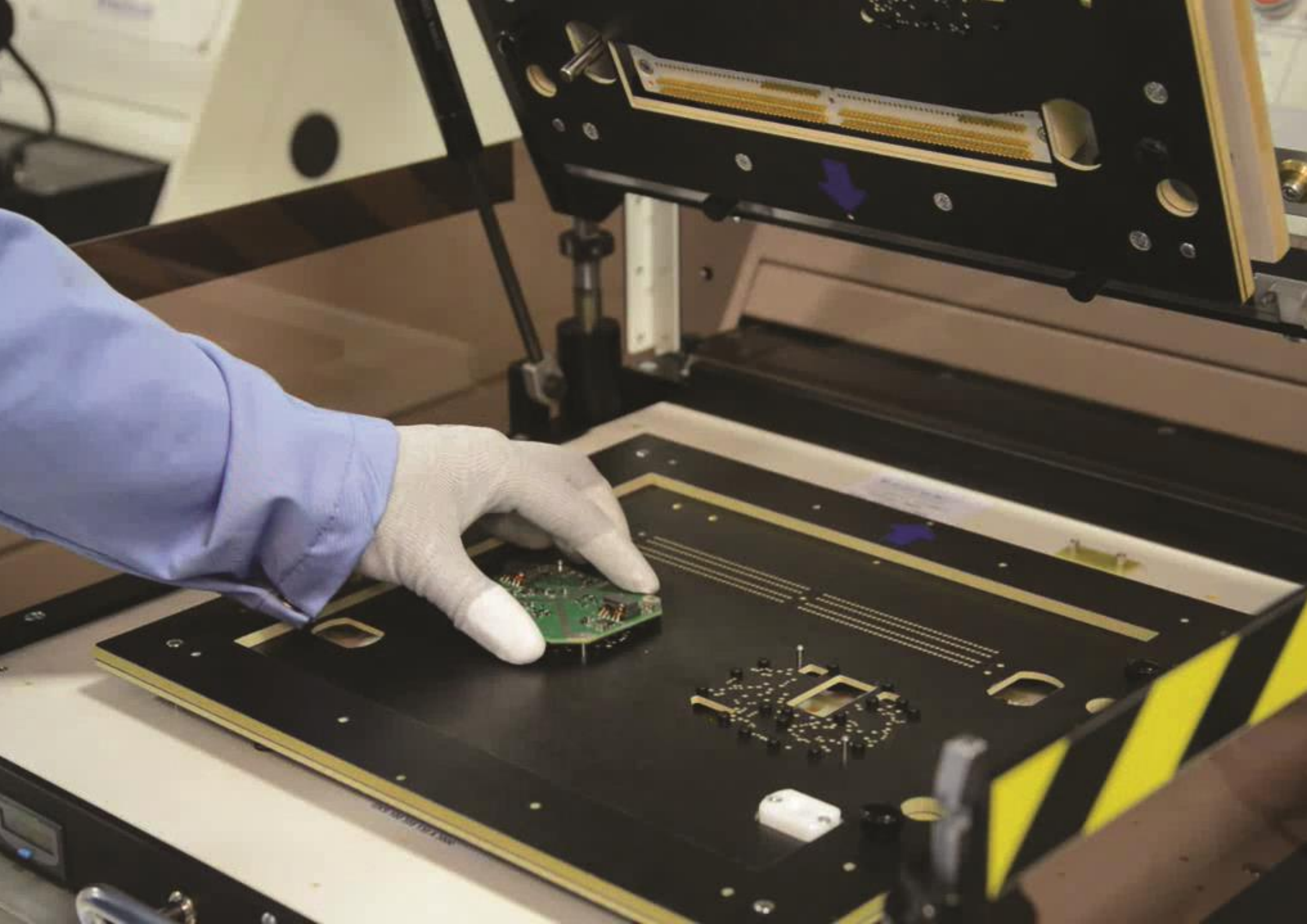
Le Compact Digital BMS Next>Series est la solution idéale pour les tests de BMS, car il s'agit de l'intégration parfaite entre un ICT et un testeur fonctionnel équipé d'un simulateur de cellule de batterie qui est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences d'un système de production.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Connexions de communication : série, USB, CAN, LIN, FlexRay, MOST, Ethernet, Ethernet 100 BaseT1
- Interfaces vidéo prises en charge : RVB, S-Vidéo, VGA, HDMI, CVBS, LVDS
- Test de génération et détection radio fréquence : BT, BLE, WiFi, téléphones portables
- Système de test GNSS : GPS, Glonass, Beidou, satellite Galileo et autres simulateurs
- Capacité de programmation embarquée (OBP)
- Boundary scan en option
- Option de test parallèle jusqu'à 4 jobs



EN SAVOIR +



## Seica

### DRAGONFLY CC NEXT>

#### INSPECTION OPTIQUE DU VERNIS DE TROPICALISATION

La Dragonfly CC Next>Series est la nouvelle solution AOI de Seica pour inspecter la dépose de vernis de protection. La combinaison de l'éclairage LED multicolore, de l'éclairage LED UV et de la caméra couleur à balayage linéaire permet une inspection claire du vernis.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Basée sur une technologie de scanner rapide et précise combinée à une lumière UV imposant la présence d'un traceur UV dans le vernis inspecté et déposé
- Permet de vérifier en 2D la présence du vernis et de mesurer sauf exception l'épaisseur uniforme de dépose (option)
- Système totalement automatisé objectif et reproductible ne dépendant pas de l'opérateur
- Convoyeur intégré compatible SMEMA facilement intégrable dans une ligne de production ou ergonomie Desktop
- Caméra CCD 18 Mpxl ou 42 Mpxl
- Programmation hors ligne possible (option)
- Compatible Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES

EN SAVOIR +



## Seica

### DRAGONFLY THT NEXT>

#### INSPECTION OPTIQUE DES COMPOSANTS TRAVERSANTS

La Dragonfly THT Next>Series est techniquement très proche de la Dragonfly CC Next> Series car basée également sur une technologie de scanner à balayage complet du PCB, permet l'inspection en profondeur des joints de soudure de composants traversants.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison de l'éclairage LED multicolore et de la caméra à balayage couleur offrant une inspection approfondie du ménisque du joint de soudure et de la détection des courts-circuits
- Acquisition par balayage complet de la surface du PCB et non seulement des composants permettant la détection des billes de soudure
- Système totalement automatisé objectif et reproductible ne dépendant pas de l'opérateur
- Convoyeur intégré compatible SMEMA facilement intégrable dans une ligne de production ou ergonomie Desktop
- Caméra CCD 18 Mpxl ou 42 Mpxl
- Compatible Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES

EN SAVOIR +



## OMRON

### VP9000

#### INSPECTION OPTIQUE 3D APRÈS SÉRIGRAPHIE (SPI)

La SPI VP9000 peut compléter la boucle d'inspection 3D de votre process avec la possibilité de corriger les excès de votre process de sérigraphie. Le process 3D unique, pour l'acquisition et la mesure des volumes de sérigraphie, garantit une fiabilité et une répétabilité unique.

##### CARACTÉRISTIQUES

- Concept unique de mesure 3D combiné à un système 2D
- Large choix de résolutions de 5µm à 25µm avec fonction unique de commutation à plusieurs résolutions
- Compensation automatique du gauchissement avec affichage de déformation PCB et fonction de données de sortie
- Simulation des valeurs et graphiques Cp / Cpk lors des modifications des seuils de spécification (USL / LSL).
- Programmation rapide
- Logiciel SPC le plus avancé avec fonction de rapport détaillé
- Fonction en boucle fermée en amont et en aval
- Très peu d'entretien



EN SAVOIR 

## OMRON

### VT-S530

#### INSPECTION OPTIQUE 3D AVANT/APRÈS REFUSION (AOI)

La VT-S530 est la solution d'OMRON pour fournir à la prochaine génération, une capacité d'inspection 3D à un coût compétitif. Avec un traitement de l'image 3D révolutionnaire, la VT-S530 analyse avec précision les caractéristiques topographiques des filets de soudure.

##### CARACTÉRISTIQUES

- 3D-SJI: Technologie brevetée COMBO unique RGB / Phase Shift
- Conformité aux normes IPC en 3D entièrement réel
- Objectif de caméra télécentrique
- Choix d'une résolution de 10 µm ou 15 µm
- Option Dual Lane (pas d'augmentation de l'emprise au sol de la machine)
- Logiciel de programmation pour la création de programmes hors ligne rapide et facile
- Surveillance des processus en temps réel
- Fonctionnalité de la station de réparation avec affichage 3D complet



EN SAVOIR 

## OMRON

### VT-S1040

#### INSPECTION OPTIQUE 3D APRÈS REFUSION (AOI)

Le nouveau système d'inspection AOI VT-S1040, est la une nouvelle génération d'AOI, basée sur un tout nouveau concept d'illumination. La combinaison d'un éclairage multidirectionnel/multicouleur, de projecteurs DPL avec déphasage multiphase pour une inspection des joints de soudure de la plus haute qualité.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Illumination MDMC, une première dans l'industrie : l'imagerie 3D sous tous les angles permet une inspection précise des formes de soudure complexes
- Élimination de l'ombre et de la réflexion secondaire avec les projecteurs à 4 directions
- Réalisation de la direction de mouillage des soudures directement liée aux normes IPC
- Des outils d'IA innovants qui prennent en charge le réglage sans compétences et
- Modèle évolutif vers un VT-S1080
- Existe en pre-reflow (VT-Z600) évolutif en VT-S1040



EN SAVOIR +

## OMRON

### VT-S1080

#### INSPECTION OPTIQUE 3D APRÈS REFUSION (AOI)

La VT-S1080 est le système AOI 3D le plus avancé au monde, conçu pour des performances système maximales et une productivité de haute qualité. Conçu pour une fabrication flexible, économisant de la main-d'œuvre grâce à une programmation IA innovante.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Rendement au premier passage jusqu'à 99 %
- Illumination MDMC, une première dans l'industrie : l'imagerie 3D sous tous les angles permet une inspection précise des formes de soudure complexes
- Élimination de l'ombre et de la réflexion secondaire avec les projecteurs MPS à 4 directions
- Réalisation de la direction de mouillage des soudures directement liée aux normes IPC
- Des outils d'IA innovants qui prennent en charge le réglage sans compétences et
- Inspection avancée en angle de vue des joints de soudure cachés
- Développé avec I4.0 à l'esprit pour une communication machine à machine avancée



EN SAVOIR +



## VT-X750

### INSPECTION 3D AUTOMATISÉE À RAYONS X (AXI)

La VT-X750 est la solution parfaite pour les fabricants désirant une inspection automatisée X-Ray, en ligne et à grande vitesse, sur les PCB contenant des composants tels que les BGA ou les CSP avec des joints de soudure cachés.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Imagerie CT 3D angulaire à rayons X de haute précision
- Inspection automatisée rapide et précise
- Génération complète de programmes hors ligne
- Création automatique de modèle de composant pour une programmation rapide et facile
- Surveillance des processus en temps réel
- Terminal de vérification des défauts et logiciel de révision d'images 3D
- Outils logiciels d'analyse de données et de contrôle qualité
- Tube fermé Micro-focus sûr et sécurisé avec méthode de rayons X à impulsion pour une durée de vie prolongée des sources de rayons X



EN SAVOIR



## XSPECTION 3000

### INSPECTION À RAYONS X

Le Xspection 3000 descend du Scienscope X-scope 3000, qui est devenu la machine à rayons X la plus populaire depuis son introduction en 2011. Son développement est principalement l'aboutissement d'années d'expérience et du dernier logiciel d'IA, avec des contributions supplémentaires de nos clients.

#### CARACTÉRISTIQUES

- La nouvelle IA adapte un algorithme d'auto-apprentissage avancé pour sélectionner les mauvaises images parmi les bonnes
- L'outil de remplissage de baril THT amélioré éliminera les vides à l'intérieur du remplissage pour les trous traversants
- Deux caméras couleur haute résolution (20 m chacune) améliorent la précision de la cartographie et permettent des mises à niveau de lecture de codes-barres et d'inspection optique
- Source de rayons X : Micro-focus, intégré (fermé)
- Tension de fonctionnement : 100kV – 130kV
- Angle de vue oblique : 40° (standard) ; 70° (facultatif)
- Table de rotation à 360° avec un diamètre de 500 mm / 20" (en option)

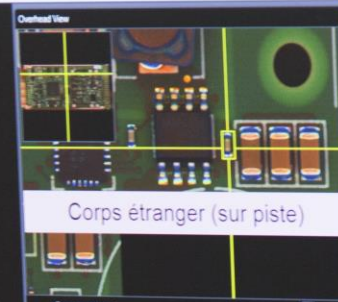
EN SAVOIR





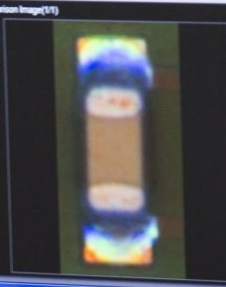


Microsoft Internet Explorer



TOP Fault Administrator

PCB Component	2013
+ R01	Hardware (Not Low)
- C20	Corps étranger (sur piste)
	Corps étranger (sur piste)
- J1	Electrode Position (Peak)
ElectroA09	Electrode Position (Peak)
- J5	Lead Wicking (angle in/out)
ElectroA7	Lead Wicking (angle in/out)
ElectroA11	Lead Wicking (angle in/out)



DELL



## IMS-100

### STATION D'ÉTIQUETAGE DES COMPOSANTS

Le système de caméra code-barres haute résolution Scienscope Reel Smart Lite avec un algorithme basé sur l'image lit n'importe quel code-barres, même avec des défauts.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Intégration MES et ERP possible
- Temps de cycle de réception rapide
- Optimiser la charge de travail de l'opérateur
- Saisie automatique des données dans l'ERP
- Traçabilité complète avec réétiquetage
- Compatible avec le déchargeur et le chargeur de tour
- Nouveau mode de double vérification des étiquettes avec caméra d'étiquettes double face
- OCR intégré



EN SAVOIR



## SMART STORAGE RACK

### ARMOIRE DE STOCKAGE INTELLIGENTE

Le rack de stockage intelligent Scienscope est le moyen le plus simple et le plus précis de stocker vos composants électroniques. Il fonctionne mieux lorsqu'il est intégré à un compteur de composants Scienscope ou à une étiqueteuse de bobines entrantes.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Intégration du système ERP et MES
- Les capteurs détectent quand et où les bobines sont tirées ou placées
- Logiciel facile à utiliser
- Facile à déplacer (roulette ESD)
- La LED multicolore permet un multi-kit à code couleur simultanément
- Affectation automatique des emplacements par lumière LED
- Compatible avec les systèmes Component Counter et IMS
- La capacité des racks dépend de la taille des bobines minimum de 130 à 1260



EN SAVOIR





## AXC-800III

### COMPTAGE DE COMPOSANTS

L'AXC-800III est la troisième génération du compteur de composants de rayons X révolutionnaire. En utilisant la technologie de pointe X-Ray et l'IA, l'AXC-800III capture les images des composants jusqu'à 01005 avec une précision de 99,9 % en moins de deux secondes par bobine.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Interface logicielle rapide, intuitive et conviviale avec une précision de 99,9 %
- Capteur de retrait de bobine pour l'impression automatique d'étiquettes
- Numérisation de (4) bobines 7" simultanément  
Numérisation de bobines 13" ou 15"
- Scanning des plateaux JEDEC et comptage des billes BGA
- Numérisation de composants enroulés lâches ou de composants enroulés étroitement
- Numérisation à l'intérieur des sacs ESD
- Bibliothèque intégrée, aucune programmation requise
- Faible empreinte au sol

EN SAVOIR

NEW



## AXC-800III PLUS

### COMPTAGE DE COMPOSANTS

L'AXC-800 III Plus rend la gestion des stocks et le comptage des composants plus rapides, plus précis et plus faciles que jamais. La nouvelle mise à niveau est livrée avec un convoyeur et un placeur d'étiquettes qui permettent un chargement, un comptage et un placement d'étiquettes simultanés

#### CARACTÉRISTIQUES

- Interface logicielle rapide, intuitive et conviviale avec une précision de 99,9 %
- Placement automatique des étiquettes une précision de mesure de 0,001 mm
- Numérisation interne des codes-barres, plus de codes-barres mixtes
- Capteur de retrait de bobine pour l'impression automatique d'étiquettes
- Numérisation de (4) bobines 7" simultanément  
Numérisation de bobines 13" ou 15"
- Scanning des plateaux JEDEC et comptage des billes BGA
- Numérisation à l'intérieur des sacs ESD

EN SAVOIR

NEW





## FUTURA F350/450

### MARQUAGE LASER

Le marquage laser est utilisé pour marquer des codes 2D, des codes-barres ou du texte sur les PCB. Bridge, avec la FUTURA F450 a développé une solution innovante dans le but de garantir un produit adapté aux exigences les plus strictes.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Marquage simultané top/bottom grâce à 2 lasers CO2 (F450)
- Zone de marquage 350x350mm (top) + 110x110mm (bottom)
- Haute vitesse (> 30% par rapport à un équipement conventionnel)
- Haute précision (taille du point 125um / 5 mils)
- Contrôle optique des mires, support central en option et reconnaissance des Bad Mark
- Contrôle OCR et de la qualité (norme automotive)
- Convoyeur avec ajustement automatique de la largeur (Fast Setup Change)
- Compatible Industrie 4.0 / MES



EN SAVOIR +



## FUTURA F700/800

### MARQUAGE LASER

Bridge, en développant une version XXL de la F350/450, répond aux évolutions de tailles des PCB toujours plus grands. La FUTURA F700 permet d'accepter des formats jusqu'à 700x700mm avec des marquage simple ou double-face.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Zone de marquage en top : 650x650mm
- Puissance de laser 10W ou 30W (option)
- Haute vitesse (> 30% par rapport à un équipement conventionnel)
- Haute précision (taille du point 125um / 5 mils)
- Contrôle optique des mires, support central en option et reconnaissance des Bad Mark
- Contrôle OCR et de la qualité (norme automotive)
- Convoyeur avec ajustement automatique de la largeur (Fast Setup Change)
- Compatible Industrie 4.0 / MES



EN SAVOIR +





## VERSAPRINT 2

### SÉRIGRAPHIE AUTOMATIQUE

Profitant d'une expérience de nombreuses années dans les process de sérigraphie, la série Ersa VERSAPRINT incarne dans sa catégorie le "Best in Class". Les modèles VERSAPRINT 2 PRO<sup>2</sup> et VERSAPRINT 2 ULTRA<sup>3</sup> offrent des avantages uniques avec un SPI intégré.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Sérigraphie automatique pour production en ligne
- Nettoyage automatique des pochoirs
- Mesure du point zéro des circuits imprimés / non imprimés à tout moment avant l'impression
- Contrôle en boucle fermée pour des résultats d'impression reproductibles
- Programmation rapide et intuitive. Machine évolutive
- Option : SPI 3D entièrement intégré (On/Off) avec inspection à 100% ou partielle (programmable) Optimisation des temps de cycle



EN SAVOIR +



## HOTFLOW ONE

### FOUR DE REFUSION

Métier historique de KURTZ ERSA, les différents fours de refusion développés exclusivement en Allemagne, permettent de répondre à l'ensemble des besoins de l'industrie électronique.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Modèle disponible jusqu'à 20 zones de chauffes et 3 de refroidissement
- Excellent transfert de chaleur avec les assemblages de cartes les plus variés
- Faible consommation d'énergie grâce à une gestion intelligente de l'énergie
- Modules de chauffage amovibles en haut et en bas
- Systèmes de transport à plusieurs voies
- Option : Support central
- Compatible Industrie 4.0 / MES



EN SAVOIR +





## HOTFLOW THREE

### FOUR DE REFUSION

Avec le HOTFLOW THREE, Ersa se prononce clairement en faveur d'une qualité de brasage encore plus élevée. Un argument de vente absolument unique : la SMART CONVECTION POWER UNIT (SCPU®). Le moteur et l'unité de commande exclusifs garantissent un profil de brasage optimisé.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Décliné en 3 versions : THREE 16/20/26 zones de chauffes
- SMART CONVECTION POWER UNIT (SCPU®)
- Système de nettoyage innovant « SMART ELEMENTS® », prolongeant la périodicité de maintenance jusqu'à 12 semaines
- Toutes les versions sont équipées d'un support central, qui peut être activé ou désactivé en option
- Zones contrôlées individuellement, ce qui permet une adaptation parfaite aux exigences du matériau et de la pâte à braser
- Option : fonctionnement sous Azote

EN SAVOIR

NEW



## EXOS 10/26

### FOUR DE REFUSION AVEC CHAMBRE SOUS VIDE

Le four de refusion EXOS 10/26 dispose de 22 chambres de chauffage par convection, une zone sous vide ainsi que 4 zones de refroidissement. Il permet de réduire le taux de voids jusqu'à 99%.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Zone sous vide permettant de réduire jusqu'à 99% le taux de voids
- Systèmes de transport à plusieurs voies
- Synchronisation parfaite des assemblages et des transitions grâce à un convoyeur surveillé par des capteurs
- Convoyeur à rouleaux sans entretien et sans lubrifiant dans le module sous vide
- Accès optimal à la chambre à vide grâce à l'unité de levage par le haut
- Système de nettoyage innovant « SMART ELEMENTS® »

EN SAVOIR



## Seica

### FIREFLY B60 NEXT>

#### BRASAGE SÉLECTIF AUTOMATISÉ PAR LASER

La nouvelle Firefly B60 Next>Series permet de faire une soudure extrêmement efficace sur n'importe quel type de carte que ce soit avec des alliages sans plomb ou à base de plomb. La fourniture d'énergie par une source laser permet un paramétrage précis de chaque point.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Basée sur une technologie laser paramétrable permettant un ajustement point par point de la puissance nécessaire au brasage
- Laser installé sur le dessous de la carte sous forme de « donut » afin de concentrer l'énergie uniquement sur la pastille et non dans le trou, empêchant les dommages aux composants
- Passage d'un process sans plomb à plomb simplement en changeant la bobine de fil de soudure
- Système totalement automatisé objectif et reproductible ne dépendant pas de l'opérateur
- Convoyeur compatible SMEMA facilement intégrable dans une ligne de production



EN SAVOIR +

## Seica

### FIREFLY T60 NEXT>

#### BRASAGE SÉLECTIF AUTOMATISÉ PAR LASER

Fonctionnement commun à la Firefly B60 Next>, la Firefly T60 Next>Series effectue à partir du dessus du circuit imprimé ou de l'application le brasage laser. Cette configuration est particulièrement adaptée aux processus automatisés dans une ligne de convoyeurs existante.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Orientée pour des applications intégrées
- Basée sur une technologie laser paramétrable permettant un ajustement point par point de la puissance nécessaire au brasage
- Laser installé sur le dessus sous forme de « donut » afin de concentrer l'énergie uniquement sur la pastille et non dans le trou, empêchant les dommages aux composants
- Passage d'un process sans plomb à plomb simplement en changeant la bobine de fil de soudure
- Système totalement automatisé objectif et reproductible ne dépendant pas de l'opérateur
- Facilement intégrable dans une ligne de production automobile pour des applications en back-end-line



EN SAVOIR +



## FLO SERIES

### TRANSITIQUE POUR LIGNE CMS

La série FLO offre un excellent rapport qualité / prix et est la solution idéale pour les lignes standards manipulant des PCB de petite à moyenne taille. L'équipement et les accessoires de la ligne FLO répondent à toutes les exigences d'une ligne CMS simple.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS PCB	DIMENSIONS TOTALES	POIDS
<b>SA-EL-BBS</b>	Stacker de PCB	450 X 350 mm	600 x 750 x 1100 mm	60 Kg
<b>SA-EL-BBD</b>	Destacker de PCB	450 X 350 mm	600 x 750 x 1100 mm	60 Kg
<b>SA-EL-LCI1S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment	450 X 350 mm	600 x 750 x 1100 mm	60 Kg
<b>SA-EL-LCI1SI</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment, entrée de four	450 X 350 mm	600 x 750 x 1100 mm	60 Kg
<b>SA-EL-LCI1SO</b>	Convoyeur de liaison, inspection, sortie de four à 1 segment	450 X 350 mm	600 x 750 x 1100 mm	60 Kg
<b>SA-EL-LCI2S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments	450 X 350 mm	(800-1200) x 750 x 1100 mm	70 Kg
<b>SA-EL-LCI2SI</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments, entrée de four	450 X 350 mm	(800-1200) x 750 x 1100 mm	70 Kg
<b>SA-EL-FLB</b>	Buffer Fifo-Lifo	450 X 350 mm	1100 x 750 x 1500 mm	90 Kg
<b>SA-EL-1ML</b>	Chargeur 1 rack	450 X 350 mm	1100 x 750 x 1500 mm	90 Kg
<b>SA-EL-1MU</b>	Déchargeur 1 rack	450 X 350 mm	1100 x 750 x 1500 mm	90 Kg
<b>SA-EL-1MUL</b>	Chargeur et déchargeur 1 rack	450 X 350 mm	1700 x 750 x 1500 mm	120 Kg
<b>SA-EL-2MU</b>	Déchargeur 2 racks	450 X 350 mm	1100x 1350 x1500 mm	200 Kg







## FLEX SERIES (1/2)

### TRANSITIQUE POUR LIGNE CMS

La série FLEX est le haut de gamme proposé par Seica Automation. Elle permet de profiter de modules totalement personnalisables à travers une liste d'options pour répondre à tous les besoins d'une ligne CMS plus rapide et complexe.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS PCB	DIMENSIONS TOTALES	POIDS
<b>SA-FC-LC1S</b>	Convoyeur de liaison, 1 segment	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
<b>SA-FC-LC2S</b>	Convoyeur de liaison, 2 segments	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
<b>SA-FC-LC1S-I</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
<b>SA-FC-LC2S-I</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
<b>SA-FC-LC1S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment, entrée de four	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
<b>SA-FC-LC1S-I</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment, entrée de four	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
<b>SA-FC-LC2S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments, entrée de four	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
<b>SA-FC-LC2S-I</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments, entrée de four	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
<b>SA-FC-LCO1S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 1 segment, sortie de four	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
<b>SA-FC-LCO2S</b>	Convoyeur de liaison, inspection, 2 segments, sortie de four	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
<b>SA-FC-LC-WBOMESH</b>	Convoyeur de sortie de four à bande plate	N/A	1411 x 655 x 925 mm	95 Kg
<b>SA-FC-TLSC</b>	Convoyeur télescopique	510 X 390 mm	1203/2003 x 773 x 1100 mm	90 Kg
<b>SA-FC-WS1S</b>	Station de travail, 1 segment	510 X 390 mm	1000 x 880 x 1889 mm	130 Kg
<b>SA-FC-WS3S</b>	Station de travail, 3 segments	510 X 390 mm	1800 x 880 x 1889 mm	160 Kg
<b>SA-FC-RS2L</b>	Station de réparation double niveau	510 X 390 mm	800 x 707 x 1752 mm	90 Kg





## FLEX SERIES (2/2)

### TRANSITIQUE POUR LIGNE CMS

La série FLEX est le haut de gamme proposé par Seica Automation. Elle permet de profiter de modules totalement personnalisables à travers une liste d'options pour répondre à tous les besoins d'une ligne CMS plus rapide et complexe.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS PCB	DIMENSIONS TOTALES	POIDS
<b>SA-FC-INV</b>	Retourneur / flip	510 X 390 mm	613 x 854 x 1287 mm	70 Kg
<b>SA-FC-TU-T</b>	Convoyeur type "T"	510 X 390 mm	903 x 903 x 1172 mm	125 Kg
<b>SA-FC-TU-L</b>	Convoyeur type "L"	510 X 390 mm	903 x 903 x 1087 mm	120 Kg
<b>SA-FC-BUF-FLSM</b>	Buffer Fifo-Lifo 1 rack	510 X 390 mm	1167 x 854 x 1702 mm	180 Kg
<b>SA-FC-BUF-FFB</b>	Buffer Fifo-Lifo 25 emplacements	510 X 390 mm	606 x 903 x 1752 mm	180 Kg
<b>SA-FC-1ML</b>	Chargeur 1 rack	510 X 390 mm	600 x 781 x 1172 mm	70 Kg
<b>SA-FC-1MU</b>	Déchargeur 1 rack	510 X 390 mm	1210 x 854 x 1701 mm	280 Kg
<b>SA-FC-2MU</b>	Déchargeur 2 racks	510 X 390 mm	1418 x 1250 x 1605 mm	280 Kg
<b>SA-FC-3MU</b>	Déchargeur 3 racks	510 X 390 mm	1986 x 1253 x 1616 mm	280 Kg
<b>SA-FC-4MU</b>	Déchargeur 4 racks	510 X 390 mm	1986 x 1253 x 1616 mm	280 Kg
<b>SA-FC-MMU</b>	Déchargeur multi-racks (jusqu'à 16 sur demande)	510 X 390 mm	2439 (min) x 853 x 1702 mm	120 Kg
<b>SA-FC-SMUL</b>	Chargeur et déchargeur 1 rack	510 X 390 mm	1588 x 853 x 1702 mm	150 Kg
<b>SA-FC-MMUL</b>	Chargeur et déchargeur multi-racks (jusqu'à 16 sur demande)	510 X 390 mm	2936 (min) x 853 x 1702 mm	250 Kg

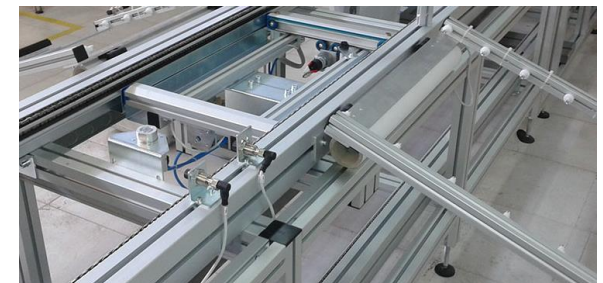
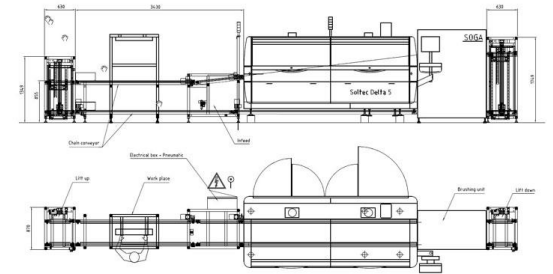
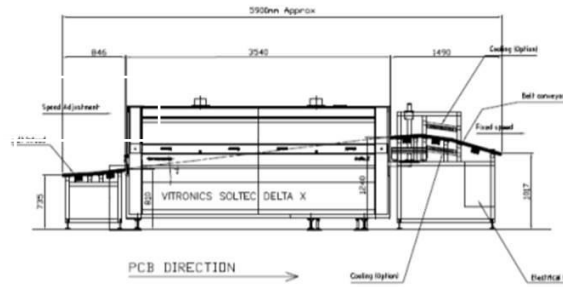




## SOLDERING LINE

### TRANSITIQUE POUR LIGNE VAGUE OU SÉLECTIVE THT

Grâce à une expertise dans les process de vague et l'automatisation, nous sommes en mesure de fournir des lignes complètes de brasage THT avec des configurations personnalisées, qui peuvent être adaptées à toutes les machines de soudure à la vague et sélective du marché.





## CANAVISIA S-BOX

### SOLUTION COMPLÈTE MONITORAGE PRODUCTION ET BÂTIMENT

Canavisia a développé un système intelligent non invasif compatible Industrie 4.0 qui permet de surveiller en permanence l'état des machines industrielles, de prévoir les éventuelles défaillances tout en optimisant les processus et les coûts de production.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Système non intrusif qui peut être adapté sur n'importe quelle ligne de production
- Solution matérielle équipée du SE-MASTER Master qui collecte et échantillonne les données provenant des modules de surveillance installés sur les machines via des modules SI-MONITOR
- Peut être connecté à n'importe quel capteur doté d'une sortie analogique de 0 à 10 V (ou, en alternative, de 4 à 20 mA) : capteurs de vibrations, de pression, de luminosité, de consommation, d'état de la tour lumineuse, de mouvement, de débit d'air, etc.
- Communique en Wi-Fi, 3G ou 4G via des protocoles ModBus, TCP Client/Serveur, IPC CFX



EN SAVOIR



## CANAVISIA SUITE SOFTWARE

### LOGICIEL EXPERT DE MONITORAGE S-BOX

En complément des S-BOX, Canavisia propose le développement de tableaux de bord spécifique à partir de son logiciel. Tous les capteurs sont affichés par un logiciel de contrôle dans une plate-forme Windows avec la possibilité de personnaliser les notifications aux utilisateurs.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Création de tableaux de bord personnalisés
- Suivi en temps réel du fonctionnement et de l'utilisation des machines
- Contrôle à distance
- Contrôle de la surveillance de la consommation d'énergie
- Tous les capteurs sont affichés sur le logiciel de contrôle et interrogeable à distance un à un
- Possibilité de personnaliser les notifications aux utilisateurs : messages texte à l'écran ou vocalement, courrier électronique
- Stockage possible des données sur serveur web sécurisé (cloud), sur MES ou en local sur base de données dédiée



EN SAVOIR



# IMPRIMANTES 3D SLS



## SINTERIT LISA PRO

### IMPRIMANTE 3D À FRITTAGE POUVRE COMPACT (SLS)

Il s'agit de l'imprimante 3D SLS compacte la plus avancée et la plus accessible du marché. Grâce à ses paramètres ouverts et à sa chambre d'azote intégrée, la Lisa PRO attire les universitaires et les chercheurs. Avec son grand volume d'impression, la Lisa PRO est le choix idéal pour le prototypage fonctionnel.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Technologie SLS

La Lisa Pro utilise le frittage sélectif par laser (SLS) pour fritter la poudre.



##### Volume d'impression

110 x 160 x 245 mm



##### Précision et résolution

Une précision jusqu'à 75 microns et une résolution XY de 25 µm



##### Chambre d'azote intégré

Imprimer avec de l'azote, idéal pour les matériaux en PA11.



##### Powder Handling Station

Objectif zéro gaspillage avec le PHS. Réutilisez toute la poudre utilisée lors de vos impressions.



EN SAVOIR +



## SINTERIT LISA X

### IMPRIMANTE 3D À FRITTAGE POUVRE COMPACT (SLS)

Sur la même base que le modèle Lisa Pro, la Sinterit Lisa X est la nouvelle imprimante 3D SLS Compacte qui offre une impression ultra-rapide, un grand espace de travail, l'accès à de nombreux matériaux et paramètres d'impression ouverts.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Technologie SLS

La Lisa Pro utilise le frittage sélectif par laser (SLS) pour fritter la poudre.



##### Volume d'impression

130 x 180 x 330 mm



##### Précision et résolution

Une précision jusqu'à 75 microns et une résolution XY de 25 µm



##### Chambre d'azote intégré

Imprimer avec de l'azote, idéal pour les matériaux en PA11.



##### Laser Galvo

Imprimer vos pièces en moins de 24h, avec la technologie Galvo de Sinterit



EN SAVOIR +





## SINTERIT NILS 480

### IMPRIMANTE 3D À FRITTAGE POUVRE COMPACT (SLS)

L'imprimante 3D NILS 480, est une imprimante professionnelle de technologie SLS dédiée à l'environnement industriel. La NILS 480 est très rapide et efficace avec un très grand volume de production vous permettant d'imprimer des pièces de grand volume. Elle donne accès à la gamme complète de matériaux et des paramètres ouverts.

NEW

#### CARACTÉRISTIQUES



#### Technologie SLS

La NILS 480 utilise le frittage sélectif par laser (SLS) pour fritter la poudre.



#### Volume d'impression

200 x 200 x 330 mm



#### Précision et résolution

Une précision jusqu'à 75 microns et une résolution XY de 25 µm



#### Laser Galvo

Imprimer vos pièces en moins de 24h, avec la technologie Galvo de Sinterit



#### Remplissage de la poudre

Système de remplissage de la poudre pour l'impression automatique.



EN SAVOIR +



## KURTZ Ersa ALPHA 140

### IMPRIMANTE 3D À FUSION SÉLECTIVE PAR LASER (SLM)

L'imprimante 3D Alpha 140 de Kurtz Ersa, est une imprimante professionnelle de technologie SLM dédiée à l'environnement industriel. L'Alpha 140 combine une technologie innovante de fabrication additive avec un fonctionnement particulièrement simple et des coûts de systèmes réduits.

NEW

#### CARACTÉRISTIQUES



#### Technologie SLM

L'Alpha 140 utilise la fusion sélective par laser pour fusionner la poudre.



#### Volume d'impression

∅ 140 x 200 mm



#### Précision et résolution

Une précision allant de 30 à 90 microns



#### Matériaux

Poudres d'acier type Inox, Aluminium, Nickel, Acier maraging ou autre sur demande



#### Laser & Optique

Laser à fibre optique (200 W)  
Diamètre focal : 140 microns



EN SAVOIR +



## zaxe

### ZAXE Z3

#### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL

Avec un volume d'impression entièrement fermé, la Zaxe Z3 offre à l'utilisateur une expérience d'impression rapide et stable. Elle combine la solide structure mécanique du système CoreXY avec la précision du mouvement pas à pas du système Klipper pour garantir un usage plus silencieux et plus rapide.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Précision d'impression

Une précision allant de 25 microns à 400 microns.



##### Volume d'impression

400 x 300 x 350 mm



##### Hotend nouvelle génération

Tête d'impression en titane E3D V6



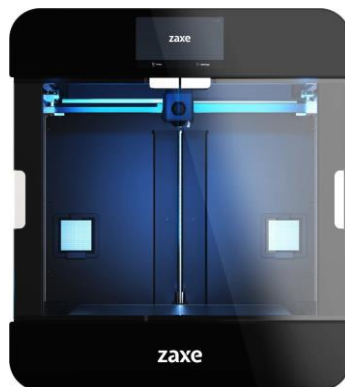
##### Enceinte close

Enceinte close avec filtre HEPA, indispensable pour vos impressions



##### Plateau flexible

Plateau d'impression en feuille PEI magnétique flexible à double texture



EN SAVOIR +

## UltiMaker

### ULTIMAKER S7 PRO BUNDLE

#### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL

Le pack d'imprimante 3D UltiMaker S7 Bundle inclus une imprimante 3D UltiMaker S7 et une Material station. C'est l'offre parfaite pour les professionnels qui veulent une offre clé en main avec un équipement totalement autonome, automatisé et fonctionnelle.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Pack clé en main

Une solution d'automatisation et de production fiable



##### UltiMaker S7

Imprimante fiable et simple d'impression en double extrusion



##### Sécurité améliorée

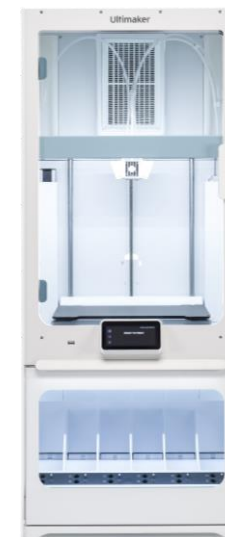
Capot de filtration intégré à l'imprimante permet de filtrer les particules fines à 95% et garantir le succès de vos impressions.



##### Material Station

Permet de stocker et protéger vos filaments de l'humidité mais aussi de rendre le pack entièrement automatisé par le chargement et changement des filaments.

NEW



EN SAVOIR +



## ANISOPRINT COMPOSER A4

### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL COMPOSITE

Cette imprimante 3D industrielle à fibre continue est fabriquée par Anisoprint. Grâce à sa technologie d'impression 3D en fibre continue. Elle peut imprimer en 3D des pièces solides, qui bénéficient de propriétés physiques et mécaniques élevées, proche de certains matériaux comme le métal.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Technologie

Une nouvelle technologie CCF pour l'impression de composites renforcés de fibres en continu



##### Précision

Une précision jusqu'à 60 microns



##### Vitesse d'impression

En FDM : 45 mm/s  
En CFC : 5 mm/s



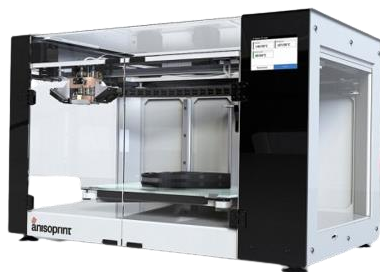
##### Volume d'impression

297 x 210 x 140 mm



##### Fibre renforcée

Fibre de carbone composite 30 fois plus résistante que les thermoplastiques, les aluminium et les alliages composites FDM



EN SAVOIR +



## RAISE3D PRO 3 PLUS

### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL

Avec son grand volume de production de 300x300x605 mm, la Raise3D Pro3 Plus vous permet d'imprimer des pièces de grandes tailles ou de placer plusieurs pièces dans le même volume d'impression. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités et composants pour plus de fiabilité et de performance.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Précision et Vitesse

Une précision jusqu'à 10 microns et une vitesse de 350 mm/s



##### Volume d'impression

300 x 300 x 605 mm



##### Hotend

Système de Hotend interchangeables



##### L'Air Flow Manager

Capot de filtration intégré à l'imprimante qui permet de filtrer les particules fines.



##### Plateau d'impression

Plateau en acier flexible avec un revêtement en Build Tak.



EN SAVOIR +





# IMPRIMANTES 3D FDM



## WASP DELTA 4070 FX

### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL

La WASP 4070 FX est une imprimante 3D grand format conçue pour imprimer des matériaux flexibles jusqu'à 50 shore A. Des impressions flexibles rapides et précises. L'imprimante 3D TPU 4070 FX intègre de nouveaux pilotes moteurs qui la rendent beaucoup plus silencieuse et précise.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Précision

Une précision allant de 50 à 300 microns



##### Vitesse d'impression

Une vitesse d'impression de 200 mm/s



##### Volume d'impression

∅ 400 x 700 mm



##### Filament Flexible

Dessiné pour imprimer des matériaux flexibles allant jusqu'à une dureté Shore de 50A.



##### Enceinte close

Indispensable pour la qualité de vos impressions



EN SAVOIR +



## WASP DELTA 4070 HDP

### IMPRIMANTE 3D À DÉPÔT DE FIL

L'imprimante 3D Pellet 4070 HDP est dotée de nouveaux pilotes de moteur qui rendent l'imprimante beaucoup plus silencieuse et précise. WASP 4070 HDP est une imprimante 3D à granulés conçue pour imprimer directement à partir de granulés de plastique.

#### CARACTÉRISTIQUES



##### Technologie HDP

Une nouvelle technologie qui permet une impression à partir de granulés : High Definition Pellet



##### Précision

Une précision jusqu'à 60 microns



##### Vitesse d'impression

Une vitesse d'impression de 150 mm/s



##### Volume d'impression

∅ 400 x 600 mm



##### Pellet

Utilisation de granulé comme consommable pour l'impression



EN SAVOIR +



# SCANNERS 3D



**AUTOSCAN INSPEC**



**EINSCAN HX**



**FREESCAN COMBO**



**FREESCAN UE PRO**

Mode de scanner	Bureautique	Multifonction	Multifonction	Métrologique
Lumière structurée / lignes laser	✓ / ✗	✓ / ✓	✓ / ✓	✗ / ✓
Vitesse de scan [points/sec]	/	480.000	1.860.000	1.850.000
Précision [mm]	0,010	0,040	0,020	0,020
Zone de numérisation [mm]	100 x 100 x 75	420 x 440	510 x 520	600 x 550
Single Line / Parallèle line	✗ / ✗	✗ / ✗	✓ / ✓	✓ / ✓
Mode de photogrammétrie	✗	✗	✗	✓

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +



Ultimaker



Material Station

Ultimaker



### Support technique

---

Nos collaborateurs sont formés sur chaque équipement et à disposition de nos clients afin de garantir des réponses dans les meilleurs délais. Différents types de contrats de service sont disponibles dont les différentes options choisies dépendent du besoin d'utilisation.



# Formations

Pendant l'installation de votre machine, nous formons vos collaborateurs à l'utilisation du nouveau moyen. Profitez des formations initiales pour vos nouveaux employés ou des formations approfondies pour les opérateurs confirmés.

**Qualiopi**  
processus certifié

FR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été attribuée pour la catégorie d'action suivante :  
**ACTIONS DE FORMATION**



### Applicatifs de test

---

Après une phase d'évaluation de vos besoins, nos ingénieurs développeront les interfaces et les programmes de test associés en fonction de vos exigences. Notre nouvel atelier mécanique créé pour la mise en œuvre de produits permet une réactivité à toute épreuve dans la création des interfaces.





[www.seica.fr](http://www.seica.fr)



[cubeeek3d.com](http://cubeeek3d.com)



+33 (1) 39 30 66 77



Suivez-nous!



La certification qualité a été attribuée pour la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

